

性能特点

- 无硅体系，低挥发物
- 高导热系数，低热阻
- 耐高低温性优越，耐气候性优异
- 优异的界面润湿性
- 物理、化学性能稳定，无腐蚀性

产品描述

PAKCOOL® PC-7660 是一款高性能导热相变片，相变温度为 50~60℃，其室温时为片状，超过相变温度后变为膏状，具有优异的润湿性和压缩性，通过调整压力和温度，使材料的 BLT 达到最小值，为获得最佳性能，该厚度通常需小于 0.04mm。该材料必须达到相变温度，才能展现其应有的性能。该产品是一种可返工的相变材料，应用于发热面和散热面之间的缝隙填充，能有效降低界面热阻，提高散热效率，可快速有效地降低电子元件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。

该产品除具有良好的导热性能和相变特性外，使用过程不会有泵出、变干或渗油的问题。另外，此产品可添加无害的溶剂做成室温下硅脂状的产品，方便施工，用于丝网印刷等工艺。

典型应用

- 微型处理器
- IGBT
- 集成电路
- 功率转换器

应用指南

- 为保护元器件与操作人员手部，所有接触导热材料的工序均需佩戴洁净一次性手套。
- 使用时将导热片贴合至工件表面，对齐定位 使用治具或手动施压 3~5 秒，使片材贴合牢固，贴合完成后控制剥离角度在 140°~180° 快速剥离表层标签膜。
- 如果环境温度过高造成揭膜困难，可先将相变片材在低温下放一会再揭

技术参数

特性	PC-7660	测试方法
颜色	灰色	目测
导热系数(W/m·K)	≥6.0	ASTM D5470
热阻@40psi, (K·cm²/W)	≤0.06	ASTM D5470
厚度* (mm)	0.25—1.0	ASTM D374
密度(g/cm³)	2.75±0.1	ASTM D792
体积电阻率(Ω·cm)	≥1.0×10¹²	ASTM D257
介电强度 (V/mm)	≥500	ASTM D149
连续使用温度(℃)	-40~125	--
*标准厚度 (mm): 0.25, 0.5, 1.0		

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

包装储运

- 可根据客户的要求进行裁切
- 无背胶
- 标准尺寸为 200mm × 400mm, 也可根据客户要求定制
- 储存及保质期: 19-24℃, 相对湿度低于 65%, 避免阳光直射, 建议储存期限: 12 个月

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。